

Cutting Edge

第70期 中間 事業のご報告

平成20年4月1日～平成20年9月30日

証券コード：6146



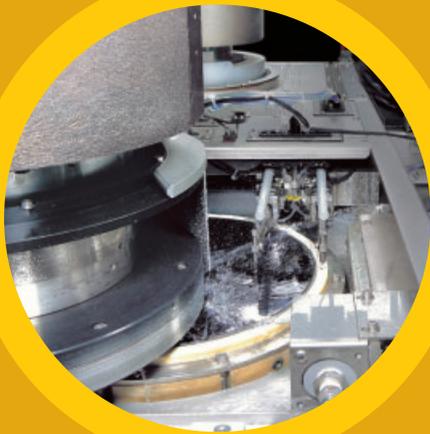
DISCO

Kiru・Kezuru・Migaku Technologies

Kiru・Kezuru・Migakuに ひたむきなDISCOを 応援してください。

DISCO Technology	さらなる極薄化をめざして
DISCO Values	グローバルな人材づくり
DISCO Business	トータル・ソリューション・プロバイダ
DISCO Workplace 1	ディスコの現場紹介





「高度なKiru・Kezuru・ Migaku技術によって 遠い科学を身近な快適につなぐ」

3つのコア技術を深めることで、
ディスコは産業と人の暮らしに貢献しています。

高度なKiru・Kezuru・ Migaku技術とは...

「切る」「削る」「磨く」は、古代から脈々と培われてきた人類に欠かせない技術です。ディスコはこの普遍的な技術を深化させ、またこの技術領域における世界のオンリーワンでありたいと考えています。「Kiru」「Kezuru」「Migaku」とローマ字表記しているのは、ディスコの技術が世界標準となり、日本語でそのまま通用するようなレベルを目指すという思いが込められているからです。

遠い科学を身近な 快適につなぐとは...

科学は日々進歩しています。しかしどれほど進歩しようともそれだけでは社会の進歩や人類の幸せに役立つとは限りません。ディスコの技術によってそんな遠い科学を人々の暮らしの豊かさや快適さに帰結させていきたいという思いを込めています。

ディスコが追い求める 成長とは...

企業の軸として据えた社会的使命に則り、あらゆるステークホルダとの価値交換を通じ、長期にわたる成長ストーリーを発信し、また実現していく。ディスコはそんな企業でありたいと考えています。

To Our Shareholders

● 株主の皆様へ

**厳しさを増す市場環境の中、一丸となって
顧客価値・企業価値の最大化に努めます。**

2008年度上期のマクロ経済環境は、原油や原材料価格の高騰などの世界的なインフレ傾向とともに、欧米の金融危機をきっかけとした景気後退局面入りが見え、危機的な状況を呈してまいりました。

半導体業界におきましては、新興国の需要増大により半導体生産数量は堅調に推移したものの、メモリ価格の長期低迷によりメーカ各社の収益悪化から設備投資需要の減退を招き、半導体製造装置市場は冷え込む結果となりました。

当社グループにおきましては、こうした中で積極的な需要の掘り起こしなどに努めましたが、主力の電子業界関連製品事業において顧客企業の設備投資抑制の影響から、精密加工装置の販売が伸び悩み、売上高の大幅な減少となりました。しかしながら、消耗品である精密加工ツールの売上は半導体生産数量の増加に伴い好調に推移し、さらに戦略分野であるレーザーはLED向けの出荷が好調となりました。

これらの結果、売上高は前年同期比23.1%減の354億97百万円、営業利益は同64.2%減の39億49百万円となりました。

世界経済の先行きを厳しく見据えつつ、レーザ技術やさらなる技術革新が見込まれる薄化技術の開発を継続的に行うことで次の収益機会に備え、長期的な成長を実現するための施策を実施していく所存です。

さらに、DISCO VALUESを実践する組織づくり、市場環境に合わせた業務の効率化と経費の圧縮に努めてまいります。株主の皆様のご支援とご鞭撻を心よりお願い申し上げます。

2008年12月

代表取締役社長



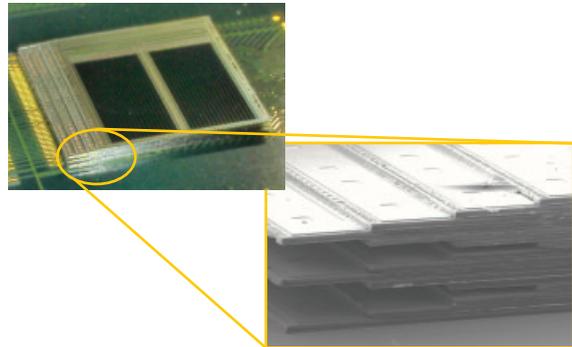
Contents

目次

- ② 株主の皆様へ
- ③ DISCO Technology
- ④ DISCO Values
- ⑤ DISCO Business
- ⑦ 中間連結財務諸表（要旨）
- ⑨ DISCOの収益構造と配当政策
- ⑩ 会社情報および株式の状況
- ⑪ 株主アンケート結果
- ⑬ DISCO Workplace ■ 1

薄化する理由

最新の携帯電話は、メール、ネット、カメラは当たり前、音楽ダウンロード、クレジット決済、ワンセグ視聴など、あらゆる便利な機能が詰め込まれています。またデジタルカメラなどで使用するメモリカードはますます大容量化しています。これらの機能を実現しているのが、ディスコの薄化技術です。チップ一枚一枚を薄くし、積層するためには、高度な技術が必要になるのです。



研究開発段階にある大容量16段積層チップの様子
(株)東芝セミコンダクター社様ご提供 第188回電子ジャーナル主催講演資料より

薄化するには

現在販売されているメモリカードには、薄さ25 μ m(1 μ m=1/1,000mm)にまで削ったメモリチップ8枚と1枚の駆動チップICが積層されています。この薄化のためには、異なる粗さの砥石で2回研削します。しかしウェーハを薄く削っていくと、その研削によるダメージが残り、チップ一個一個に切り分ける際にカケやワレの生じる原因となります。そのため「ストレスリリーフ」と呼ばれる研磨工程を最後にすることで、そのダメージを除去するのです。



高精度なディスコの薄化技術により、回路付きウェーハを5 μ m厚(普通紙の1/20の厚さ)まで薄くすると、光を透過するほどになります。

ディスコの強み



ディスコは創業以来、「切る(Kiru)」「削る(Kezuru)」「磨く(Migaku)」技術にこだわり、この領域を極限まで掘り下げることで成長を遂げてきた企業です。ディスコの最大の強みは、お客様からのいかなるご要望にも着実にお応えできるソリューションプロバイダ*としての役割を担い、幅広いアプリケーション技術や製品ラインナップを提供できる点にあります。

*手段のみではなく結果までをお届けする役割

人材も世界基準で

現在、海外売上高が連結売上高の66.5%に達しているディスコのグローバルネットワークは、アメリカ、アジア、欧州の14カ国21拠点(代理店除く)に拡大しています。技術開発・製品の販売・技術サポート・メンテナンスなどの多様なサービスを通して海外現地のお客様がディスコの提案にご満足していただくためには、優秀な人材をグローバルに確保し、育成することが急務となっています。

ディスコでは、1997年に人種や国籍にとらわれない人材採用を開始。現在では本社勤務1,000名の社員中34名の外国籍社員が在籍し、技術・営業・マーケティングなど様々な分野で活躍しています。さらに、海外の販売拠点の役員・マネージャークラスの大半は現地の者を採用しています。

また、DISCO VALUESにおいても国籍、人種、宗教など、その人の属性を評価の基準としないことが謳われており、ミッションの実現のためにはグローバルに人材を採用、育成し、処遇していくことが当たり前である、という考えが明示されています。

待遇もルールも世界共通

優秀なグローバル人材を獲得し、長期にわたってディスコの価値観を共有し、発展に寄与してもらうためには、育成システムの構築とともに、日本人正社員と分け隔てのない採用・人事考課(評価と待遇)の基準を整備する必要があります。そのためにディスコでは、1997年のグローバル人材採用開始とともに新たな人事賃金制度を導入しました。

これは「グローバル社員」を日本人の高度専門人材向けの「特別職」と同等に、3年契約の年俸制で退職金の代わりに「契約更新手当」(前年年俸の10%)と、貢献度に応じた「インセンティブボーナス」を払うなどの工夫を行っています。

このようにグローバルな人材に対し、ディスコでは活躍する機会を広げるための多様な対応を取ること、よりよい価値交換が可能であると考えています。



Total Solution Provider

精密加工装置・精密加工ツール・アップ
～本ページでは、それぞれの精密加工装置が果たす

リケーションが三位一体となり、手段のみではなく結果までをお客様にお届けします
役割や特徴などについてご説明します～

得意な分野を活かしてKiru技術の広がりに対応する

Kiru

Laser Saw

レーザダイサの特徴

- 非接触加工
- 水を使わない加工
- 薄い素材に向く
- 空洞のある構造物を切り出す加工に向く
- 硬く脆い素材の加工に向く



Dicing Saw

ブレードダイサの特徴

- 視認できる安定した加工
- 蓄積された豊富なノウハウ
- 砥石交換が容易なため汎用性が高い
- メンテナンスが容易
- 厚い素材に向く
- シリコン素材の加工に向く



レーザダイサとブレードダイサによる切削技術の広がりには双方の異なる強みを活かし、多様化するKiruニーズに対応していきます。

お客様の要望に応じた多くのKezuru・Migaku技術を用意し真っ先に相談される存在となる

Kezuru



粗研削

目の粗い砥石を用いて要求に近い厚さまで一気に削り込みます。加工面はくもり、写真(上)のように文字が映り込みません。



仕上げ研削

目の細かい砥石を用いて粗研削の凹凸を取り除きます。加工面は鏡のようになり、写真(上)のように文字が映り込みます。

Migaku



ポリグランド

仕上げ研削用に比べて、極限まで目を細かくした砥石を用いて行うストレスリリーフ技術*。



ドライポリッシング

水や化学薬液を一切使用しない特殊な研磨布を用いたDISCOオリジナルのストレスリリーフ技術*。



ドライエッチング

フッ素系ガスのプラズマ(電気のかかった気体の一種)によりダメージの除去を行うストレスリリーフ技術*。



E Pad

環境負荷低減と生産性向上を両立させた、ダイヤモンド砥粒を固着した湿式パッドによるストレスリリーフ技術*。

*ストレスリリーフ技術：研削によって加工面に生じた微細な傷(ダメージ)を除去することにより、強度の高いチップを製造する技術

中間連結財務諸表(要旨)

中間連結貸借対照表

(単位:百万円)

科目	第69期中間 平成19年 9月30日現在	第70期中間 平成20年 9月30日現在	第69期通期 平成20年 3月31日現在
■資産の部			
流動資産	73,113	55,733	69,881
固定資産	44,493	53,071	48,772
有形固定資産	37,034	45,410	41,236
無形固定資産	892	828	876
投資その他の資産	6,565	6,832	6,608
資産合計	117,606	108,805	118,603
■負債の部			
流動負債	28,184	15,921	26,364
固定負債	2,747	2,357	2,573
負債合計	30,931	18,278	28,937
■純資産の部			
株主資本	85,269	89,935	88,770
資本金	14,510	14,517	14,517
資本剰余金	15,592	15,599	15,599
利益剰余金	55,221	60,090	58,924
自己株式	△55	△271	△270
評価・換算差額等	791	100	161
その他有価証券評価差額金	40	19	24
為替換算調整勘定	750	80	136
新株予約権	126	310	207
少数株主持分	488	181	525
純資産合計	86,675	90,527	89,665
負債純資産合計	117,606	108,805	118,603

中間連結損益計算書

(単位:百万円)

科目	第69期中間 自平成19年4月1日 至平成19年9月30日	第70期中間 自平成20年4月1日 至平成20年9月30日	第69期通期 自平成19年4月1日 至平成20年3月31日
売上高	46,140	35,497	91,618
売上原価	22,350	18,000	44,757
売上総利益	23,790	17,496	46,860
販売費及び一般管理費	12,763	13,546	27,526
営業利益	11,026	3,949	19,333
営業外収益	294	324	625
営業外費用	289	207	1,394
経常利益	11,031	4,066	18,564
特別利益	77	62	176
特別損失	75	447	287
税金等調整前中間(当期)純利益	11,033	3,681	18,452
法人税、住民税及び事業税	4,029	1,012	6,071
法人税等調整額	748	19	1,186
少数株主利益(△損失)	53	△9	82
中間(当期)純利益	6,201	2,659	11,112

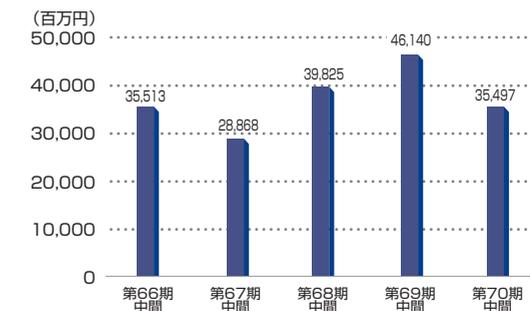
中間連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

科目	第69期中間 自平成19年4月1日 至平成19年9月30日	第70期中間 自平成20年4月1日 至平成20年9月30日	第69期通期 自平成19年4月1日 至平成20年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,333	3,264	9,296
投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,062	△8,632	△11,825
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,879	△1,472	△3,180
現金及び現金同等物に係る換算差額	51	425	△272
現金及び現金同等物の増加額(△減少額)	△4,556	△6,414	△5,982
現金及び現金同等物の期首残高	24,045	18,062	24,045
現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高	19,488	11,648	18,062

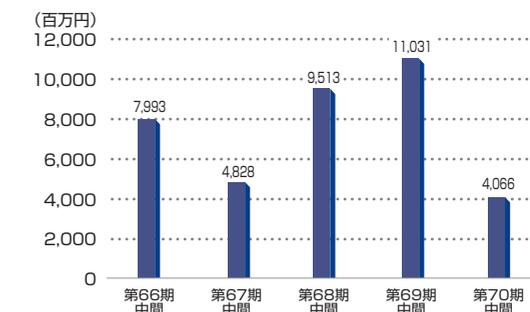
売上高

半導体業界におきましては、特にメモリにおける製品需給バランスの崩れが半導体メーカーの収益を圧迫しております。このような状況のもと、当社は消耗品である精密加工ツールやレーザ分野の需要拡大に努めてまいりましたが、半導体業界全体において設備投資意欲が減退していることから、精密加工装置の売上高は前年同期に比べ大幅に落ち込みました。この結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は前年同期比23.1%減の354億97百万円となりました。



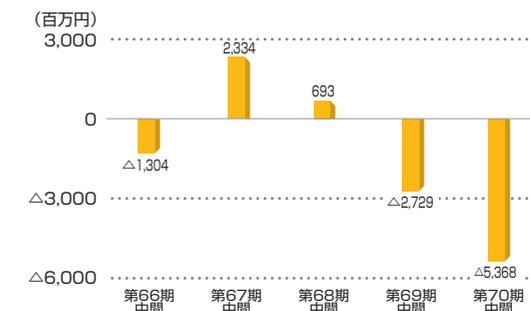
経常利益

利益面におきましては、半導体市況の厳しい状況を踏まえ、削減可能な経費の圧縮に努めております。しかし、中長期的な視点から競争力の強化と将来の技術ニーズに応えるために先行的な開発投資は継続して行っております。また、前年同期と比べ為替差損の減少などにより、営業外での利益幅が微増となりました。以上の結果、当第2四半期連結累計期間の経常利益は前年同期比63.1%減の40億66百万円となりました。



フリーキャッシュ・フロー

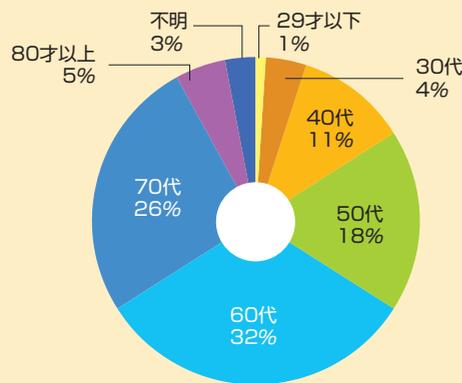
当第2四半期連結累計期間におきましては、営業活動の結果得た資金は32億64百万円となりましたが、積極的な研究開発と生産能力の増強を目的とした有形固定資産の取得等により投資活動で使用した資金が86億32百万円となったことから、フリーキャッシュ・フローは53億68百万円の支出となりました。



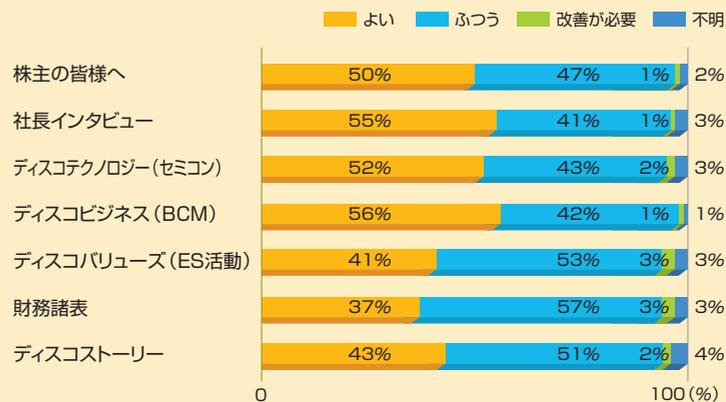
株主アンケート結果

「第69期事業のご報告」にて実施したアンケートにご協力いただき、誠にありがとうございました。2,000件を超すご回答をいただき、回答率は15.4%となりました。皆様の貴重なご意見を今後のIR活動に役立てていきたいと考えております。

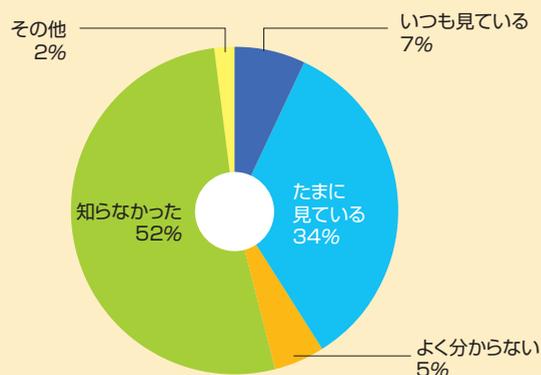
アンケート回答者年齢層



第69期事業のご報告について各項目の評価

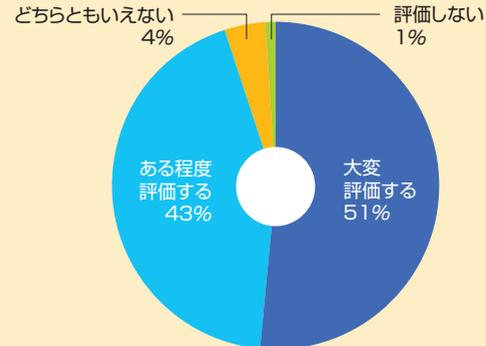


当社の速報開示※について



※速報開示とは：投資家の皆様に対し、当社業績に関するリアルタイムでの情報提供を行うことを目的とし、四半期ごとに個別売上高が判明した時点、および連結売上高・個別業績が判明した時点で、それぞれ速報値として任意で開示をするものです。

今回の追加配当政策についてどのようにお考えですか
(4年累計連結売上高経常利益率20%以上達成の場合、配当性向24%適用)



Q 環境活動に取り組んでいますか？

A ディスコは2010年までに達成すべき具体的な環境目標を策定し、それに向けた活動を展開しています。具体例として2003年より使用済み装置を解体しリサイクルする活動などに取り組んでいます。2007年には全ての部品がグリーン調達※に対応した初の精密加工装置DAD322および周辺機器DCS1440・1460を開発しました。また、新開発のろ過フィルタにより加工後の廃水をクリーンにし再利用することで、排水ゼロを実現する超純水リサイクル装置DWR1720をSEMICON Japan2008にて出展しました。

※グリーン調達：部品などを調達する際に環境負荷の少ないものから優先的に選択すること



ホームページで
ご覧いただけます。

自由コメントなど、当紙面では紹介しきれなかった内容を、当社「株主・投資家情報」サイトにて掲載しております。

Q 社会貢献活動を行っていますか？

A ディスコでは経営理念である「DISCO VALUES」の浸透を通じて、社会の中の良き市民として地域からその存在が歓迎されるよう日々努めています。具体的な社会貢献活動では、2007年度に所轄消防署長より委託された救命講習講師資格に基づいた講習を地域住民の方々にも公開しています。また、防火防災力を高めることを目的として参加している自衛消防隊操法大会にて、本社・大森地区および広島事業所・呉地区において、男子隊・女子隊ともに優勝しました。さらに、大田区文化支援事業への協賛、広島事業所やヨーロッパの子会社において献血運動なども行っています。



大森地区消防隊操法大会での記念撮影 消火活動を行うディスコ女性隊員

IRニュースメールの配信登録
をお待ちしています。

決算発表やプレスリリースなど、IR関連情報を受け取ることができます。当社ウェブサイトにてぜひご登録ください。

ディスコの生産工場(呉工場・桑畑工場・長谷工場)では、良質な製品を安定してお客様に提供できるよう、日々さまざまな改善活動を行い『進化』を遂げてきました。徹底した品質と納期の管理を行う一方、事業継続管理(BCM※)や環境配慮にも積極的に取り組み、広島事業所はステークホルダから信頼される生産拠点となっています。本ページでは、バーチャル工場見学と題して少しでも現場の『進化』を体感していただきたく、その一部をご紹介します。

※BCM: Business Continuity Managementの略

桑畑工場に中国・四国地方最大級の太陽光発電システムを導入

事業活動に伴う環境負荷を低減するために、桑畑工場に中国・四国地方最大級の太陽光発電システムを導入しました。設置面積は約2,000m²で、杉の木が1年間に吸収するCO₂に換算すると約11,600本分の発電量となります。

1日最大200kWh発電するソーラーパネル



担当作業者の作業効率を向上させ装置の工期を70%短縮

担当作業者の無駄な動きを徹底的になくす改善を行っています。インカムを用いることで、指示を聞くために移動する時間を省き、また歩数計を身につけることで動線を意識し、取り掛かる作業の段取りに工夫を凝らすようになりました。

インカムをつけて作業する作業員



既存棟

新棟(建設中)

※本CGイラストは完成予定図です

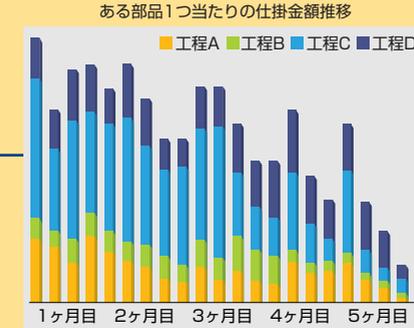
HIROS HIMA

Works

広島事業所

基本データ ※呉工場・桑畑工場・長谷工場の合算値

敷地面積 136,559m² (参考/東京ドームグラウンド広さ:13,000m²)
 建築面積 46,046m²
 全従業員数 約1,800名(2008年9月末時点)
 ※外注社員・派遣社員含む



積極的な改善活動で一部生産部品の仕掛品を削減

装置に組み込む部品の製造にかかる仕掛金額の削減を目指した改善活動の結果、半年でこれを約1/6に圧縮しました。工程を見直し並行して作業に取り組むほか、繰り返す作業負荷を軽減する補助工具を内製しました。



地震被害を最小化する免震構造の新棟を建設中

万が一の地震被害によりディスコ製品の供給が長期にわたって止まった場合、お客様の生産活動に多大な影響を与えてしまいます。この事態を未然に防ぎ、安定して供給できる体制(事業継続管理)の構築に注力しています。

駐車場から見える免震構造とその内部



“出前授業”風景

近隣の小・中学校にて“出前授業”を実施

ディスコ社員が呉市の小・中学校に直接赴き、「KKM※・安全・環境」についての授業を行っています(2006年より計9校16授業実施)。クイズや寸劇などの工夫を凝らし、ディスコらしく地域社会に貢献できる活動を行っています。

※ KKM: Kiru・kezuru・Migakuの略

株主メモ

事業年度	毎年4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会	毎年6月
期末配当金 受領株主確定日	毎年3月31日
中間配当金 受領株主確定日	毎年9月30日
株主名簿管理人	〒100-8212 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社
同連絡先	〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号 TEL 0120-232-7111 (通話料無料) 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
同取次所	三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店(下記ご注意ください)

株式に関する手続き用紙のご請求について

株式に関する手続き用紙(届出住所等の変更届、配当金振込指定書、単元未満株式買取請求書等)のご請求につきましては、以下のお電話ならびにインターネットにより24時間受け付けておりますので、ご利用ください。なお、株券電子化実施後は、特別口座に記録された株式についてのお手続き用紙のみとなりますので、ご注意ください。

TEL 0120-244-479 (通話料無料)

インターネットアドレス <http://www.tr.mufig.jp/daikou/>

公告の方法

電子公告により行う。

ただし、やむを得ない事由により電子公告ができないときは日本経済新聞に公告いたします。

証券コード

6146

(ご注意) 株主名簿管理人の「取次所」の定めについて

株券電子化後、株主様の各種お手続きは、原則として口座を開設されている金融商品取引業者経由で行っていただくこととなるため、株主名簿管理人の「取次所」は、株券電子化の実施時をもって廃止いたします。

なお、未受領の配当金のお支払いにつきましては、引き続き株主名簿管理人である三菱UFJ信託銀行の本支店でお支払いいたします。

株券電子化実施に伴うお知らせ

1. 株券電子化前後における単元未満株式買取・買増のご請求について

(1) 保管振替制度をご利用でない単元未満株式に関するご請求

① 単元未満株式買取請求

平成21年1月5日(月)から平成21年1月25日(日)までは、受付をいたしません。

また、平成20年12月25日(木)から12月30日(火)までのご請求受付分につきましては、買取価格はご請求受付日の終値を適用いたしますが、買取代金のお支払いを平成21年1月30日(金)とさせていただきます。

② 単元未満株式買増請求

平成20年12月12日(金)から平成21年1月25日(日)までは、受付をいたしません。

(2) 保管振替制度をご利用の単元未満株式に関するご請求

株券電子化実施の前後において、一定期間お取引の金融商品取引業者で取次ぎを行わないと承っております。具体的な日程につきましては、金融商品取引業者により異なることが考えられますので、お取引の金融商品取引業者にお問い合わせください。

2. 株主様のご住所およびお名前のご登録について

株主様のご住所およびお名前の文字に、振替機関(証券保管振替機構)で指定されていない漢字等が含まれている場合には、その全部または一部を振替機関が指定した文字に置き換えるうえ、株主名簿にご登録いたします。この場合、株主様にお送りする通知物の宛名は、振替機関が指定した文字となりますのでご了承ください。

“Cutting Edge” とは...

Cutting Edgeとは、辞書で引くと「刃の先端」という意味のほかに、「最先端」という意味があります。ディスコの「高度なKiru・Kezuru・Migaku技術によって遠い科学を身近な快適につなぐ」という企業ミッションをより深くご理解いただくために、常に最先端の技術を提供することを通じて、社会に積極的に貢献していきたいという願いをこのタイトルに込めました。

これからも、ディスコの最先端の技術情報とともに、報告内容を充実してまいりますので、どうぞよろしく願いたします。

